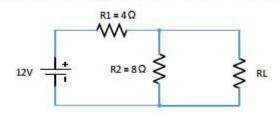
第十二届 蓝桥杯 EDA设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题 (30分)

不定项选择 (3 分/题)

(1) 调节电路中的可调电阻 RL, 使 RL 获得最大的功率时, 流过 R1 的电流值为()。



A. 0. 5A

B. 1A

C. 1.5A

- D. 3A
- (2) 线路板设计中常用 mil 作为单位, 它与 mm 的换算关系是 ()。
 - A. 1mi1 = 0.0254mm
- B. 1mi1 = 0.02mm
- C. 1mi1 = 0.254mm
- D. 1mi1 = 0.2mm
- (3) 串口通信中用于描述通信速度的波特单位是()。
 - A. 字节/秒

B. 位/秒

C. 帧/秒

- D. 字/秒
- (4) 一般情况下,与线路板的"层数"相关的是()。
 - A. 丝印层

B. 信号层

- C. 机械层
- D. 电源层
- (5) 与 A+B+C 相等的表达式为 ()。
 - A. $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
- B. $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
- C. $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
 - D. $\overline{A} \cdot \overline{B} + C$
- (6) 下列哪个电路不是时序逻辑电路()。
 - A. 计数器

B. 寄存器

- C. 译码器
- D. 触发器
- (7) 下列由 Altium Designer 导出的文件中,哪些可以反映元器件连接关系()。
 - A. user. rul
- B. user.xls
- C. user. dblink
- D. user. net

(8)	当放大电路的电压增益为-20dl	3时	,说明它的电压放大倍数为()。	
	A20 倍	В.	20 倍	
	C. 10 倍	D.	0.1倍	
(9)	PCB设计过程中,希望在顶层	8出	部分铜皮,应在哪个层进行绘制()。
	A. Top Layer	В.	Top Overlay	
	C. Keepout Layer	D.	Top Solder	
(10)	网络表中描述了电路元器件的	().	
	A. 编号	В.	封装	
	C. 功能	D.	引脚连接关系	